

Pressemitteilung

InfraTec GmbH Infrarotsensorik und Messtechnik

Dresden, den 10. September 2026

Lock-In-Thermografie für Elektronik- und Halbleitermodulprüfung **Thermische Auffälligkeiten und lokale Leistungsverluste innerhalb kürzester Prüfzeiten** **detektieren**

In unserem englischsprachigen, kostenfreien InfraTec Online-Event „*Infrared Lock-in Thermography for Inspection of Electronics and Integrated Circuits*“ erfahren Sie mehr über die Lock-In-Thermografie als bildgebendes Verfahren zur berührungslosen und zerstörungsfreien Prüfung in der Elektronik und Elektrotechnik.

Online-Event (Sprache: Englisch)

“Infrared Lock-in Thermography for Inspection of Electronics and Integrated Circuits”

Datum: Mittwoch, 04. November 2026

Uhrzeit: 10:00 - 12:00 Uhr (MESZ)

Sprache: Englisch

Preis: kostenfrei

Anmeldung unter:

<https://attendee.gotowebinar.com/register/5340007369891108697?source=PR-extern>

Die Inspektion elektronischer Komponenten und Baugruppen mit Hilfe der Aktiv-Thermografie ist ein etabliertes Prüfverfahren zur Fehlersuche und Qualitätssicherung – von der Prototypen-Entwicklung bis hin zur Serienproduktion. Mit diesem äußerst empfindlichen Verfahren lassen sich atypische Temperaturverteilungen und Hotspots mit Variationen von wenigen Millikelvin an Oberflächen von Leiterplatten, integrierten Schaltkreisen und Multichip-Modulen zuverlässig berührungslos detektieren.

Die Lock-In-Thermografie liefert hochdetaillierte Informationen während eines jeden Entwicklungsschrittes. Diese können anschließend für das Design von komplexen elektronischen Schaltkreisen bzw. Baugruppen zur Optimierung des Wärmemanagements herangezogen werden. Insbesondere in der Elektronikproduktion wird die aktive Thermografie als vielseitiges Instrument eingesetzt: u. a. bei der Qualitätssicherung, zur permanenten Überwachung technologischer Parameter sowie zur Inline-Inspektion von Produkten in der Fertigung und zur abschließenden Qualitätskontrolle.

Bei der Lock-In-Thermografie werden durch die definierte elektrische Anregung eines elektronischen Bauteiles oder einer Baugruppe lokale Wärmequellen generiert. Diese Wärmequellen haben ihren Ursprung in regulären, aber auch irregulären (elektronischen) Strukturen des Bauteils bzw. der Baugruppe. Durch Abgleich mit Simulationen und/oder Referenzmustern können irreguläre Wärmequellen anhand ihrer Lage aber auch ihrer Temperaturüberhöhung eindeutig identifiziert werden.

Informationen: 2.471 Zeichen (inkl. Leerzeichen)

Pressemitteilung

InfraTec GmbH Infrarotsensorik und Messtechnik

Über InfraTec

Die InfraTec GmbH Infrarotsensorik und Messtechnik wurde 1991 gegründet und hat ihren Stammsitz in Dresden. Das inhabergeführte Unternehmen beschäftigt mehr als 240 Mitarbeiter und verfügt über eigene Entwicklungs-, Fertigungs- und Vertriebskapazitäten.

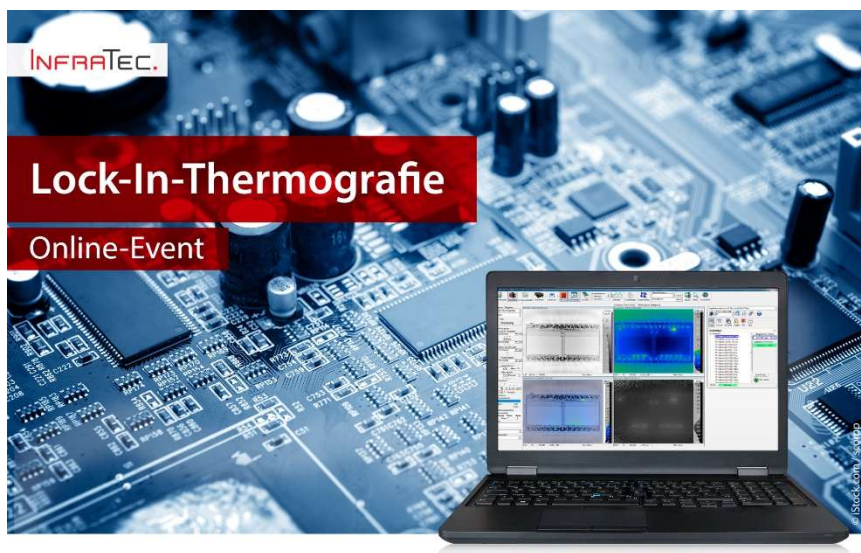
Im Geschäftsbereich Infrarot-Sensorik werden pyroelektrische Infrarot-Detektoren entwickelt und hergestellt, die als optoelektronische Komponenten in Sensoren und Geräten der Gas- und Flüssigkeitsanalyse, der Flammendetektion sowie der Spektroskopie Anwendung finden.

Mit dem Geschäftsbereich Infrarot-Messtechnik zählt InfraTec zu den führenden Anbietern kommerzieller Wärmebildtechnologie. Neben der High-End-Kameraserie ImageIR® und der Produktfamilie VarioCAM® HD liefert das Unternehmen schlüsselfertige Thermografie-Automationslösungen für zahlreiche Anwendungsfelder wie u. a. die Qualitätssicherung in der Automobilproduktion, die zerstörungsfreie Prüfung elektronischer Baugruppen sowie die Überwachung kritischer Infrastruktur.

Pressekontakt

Firmenanschrift:	InfraTec GmbH	Telefon	+49 351 82876-600
	Infrarotsensorik und Messtechnik	Fax	+49 351 82876-543
	Gostritzer Str. 61 – 63	E-Mail	thermo@InfraTec.de
	01217 Dresden	Internet	www.InfraTec.de

Bild



Online-Event: "Infrared Lock-in Thermography for Inspection of Electronics and Integrated Circuits"